

: , .
 : ,

- CEM (COMPOSIT EPOXCY MATERIALS GRADEL) /CEM3
- FR-4()
- PP (PAPER POLYESTER)

?
 가
 가
 ?
 가
 .
 ,
 .

1.

1).

, 가 ()

2).

, 가 ,
 , 가 가 ,

3).

, ,
 ,
 가 가

4).

, , ,

(sem1)/ (sem2))

,

2. (FPC)

1).

가
가

2).

400
가

가

PREPREG

(0.97T

)

MLB 가 SCALE()

(150 1 가)

3.

RESIST 가 HOT ROLLER D/F RESIST

D/F LAMINAT OPEN .SHORT

D/F ROLLER 100±10
가 : D/F GAS가 OPEN.SHORT
가 : D/F OPEN.SHORT
ROLL 35±0.5kg/cm²
60±10

1). P/N(PANEL)
HOLE MIN 15μm
HOLE

- 2).
 P/N TH
 .(0.3 μ m)
 ALKALI NAOH
 HCHO
 HCHO PH11.5 ION
- 3).
 P/N HOLE
 P/N A()
- 4). P/T
 P/T PATTERN RESIST PATTERN PATTEN
 ETCHING RESIST
 SOLDER
- 5). S/R
 S/R PRINT SOLDER SODLER
 PRINT SOLDER RESIST
 SOLDER MASK
 SCREEN SOLDER RESIST INK SQUEEGEE 가
 SCREEN FRAME INK INK
- 6). HAL
 PCB
 SOLDERING
 SOLDER SOLDER ABILITY
 HASL(HAT SOLDER LEVERING)
 SOLDER 2 μ m~50 μ m
 2 μ m~30 μ m
 FLUX CI
 SOLDER
 HAL(SOLDER) FLUX CU SOLDER 가
 SOLDER
 SOLDER SN()63%, Pb() 37%
 HAL M/C 250 $\pm$ 5
- 7).
 (HARD GOLD) NI AU
 CONNECTOR
 1. SHEARING

2. P/T P/T TAPE MASKING
 3. TAPE TAPE
 4. NI-AU SLODER .
 5. SLODER
 - 6.
 7. NI ()
 8. AU NI (NI)
 9. AU ()
 - 10.
 11. TEST
- NI 2~5 μ m AU0.3 μ m ~ 0.76 μ m

§

(CO SOFT GOLD .

)

AU NI

AU-CU 가 CONNECTOR .

CU AU AU CU AU CU

AU AU CU

8).

SOFT GOLD .

SOFT GOLD .

AU .

NI 2 μ m~5 μ m AU 0.03 μ m

WETTING .

가 .

4. 가

가 USER 가

가 .

1). 가

1. PRESS

가

1.

2.

3. 가

2. ROUTER

ROUTER

가

ROUTER PROGRAM

ROUTER 가

BIT

BIT 가 .
BIT 0.8Ø~3.175Ø
ROUTER
±0.2mm ±0.15mm
3. BEVELLOR
CONNECTOR
30°±10°
4. V-CUT
V-CUT USER
가
가 0.8T~ 2.0T